

Product Change Notice (PCN)

件名：RA6M2/RA6M3/S3A3/S5D5/S5D9 シリーズ LFQFP パッケージ リードフレーム変更のご案内

発行日：5/27/2025

出荷開始予定日：9/1/2025

改版履歴：初版

変更内容の説明：

対象製品：RA ファミリ RA6M2/RA6M3 シリーズおよび SYNERGY ファミリ S3A3/S5D5/S5D9 シリーズの LFQFP-144 ピン製品

対象後工程拠点：Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd

変更内容：リードフレームを変更します。

対象製品リスト：

別紙 型名一覧表を参照してください。

変更の理由：

安定生産の為

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響：

外形に変更はございません。実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。

製品の識別方法：

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。

信頼性データについて：

信頼性確認済です。弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

サンプル出荷予定日：9/1/2025

サンプルのご要求につきましては、6/30/2025 までに弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

製品/材料の化学物質データ：

弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

ご注意：

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

別紙 型名一覧

No.	型名	パッケージ外形	ピン数
1	R7FA6M2AD3CFB#AA0	LFQFP	144
2	R7FA6M2AD3CFB#BA0	LFQFP	144
3	R7FA6M2AF3CFB#AA0	LFQFP	144
4	R7FA6M2AF3CFB#BA0	LFQFP	144
5	R7FA6M3AF3CFB#AA0	LFQFP	144
6	R7FA6M3AF3CFB#BA0	LFQFP	144
7	R7FA6M3AF3CFB#HA0	LFQFP	144
8	R7FA6M3AH3CFB#AA0	LFQFP	144
9	R7FA6M3AH3CFB#BA0	LFQFP	144
10	R7FS3A37A3A01CFB#AA0	LFQFP	144
11	R7FS3A37A3A01CFB#BA0	LFQFP	144
12	R7FS5D57A3A01CFB#AA1	LFQFP	144
13	R7FS5D57A3A01CFB#BA1	LFQFP	144
14	R7FS5D57C3A01CFB#AA1	LFQFP	144
15	R7FS5D57C3A01CFB#BA1	LFQFP	144
16	R7FS5D57C3A01CFB#HA1	LFQFP	144
17	R7FS5D97C3A01CFB#AA0	LFQFP	144
18	R7FS5D97C3A01CFB#BA0	LFQFP	144
19	R7FS5D97E3A01CFB#AA0	LFQFP	144
20	R7FS5D97E3A01CFB#BA0	LFQFP	144

・補足資料

1.仕様相違点の概要

項目		変更前	変更後	備考
組立工程拠点		Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd		-
選別工程拠点				-
部材	リードフレーム	リードフレームA	リードフレームB 但し材質は同等	-
	モールド樹脂	-	変更なし	-
	ダイマウント	-	変更なし	-
	チップ厚	-	変更なし	-
パッケージ	外形図	-	変更なし	-
マーク	フォント	-	変更なし	-
梱包材	結束バンド色	-	変更なし	-
保管条件	開封後	-	変更なし	-

※信頼性・製品特性に変更はございません。

2.4 M変化点（組立工程部材変更・追加）

検証項目	検証結果	判定
製造装置 Machine	現行品と同じです。	○
製造方法 Method	現行品と同じです。	○
作業員 Man	現行品と同じです。	○
材料 Material	認定した材料のみを使用致します。 完成品においても現行品と同等な信頼性試験を実施しており 問題ない事を確認しております。	○

3. 信頼性試験結果

Test Items	Test Conditions	ResultsFailure/Size
High Temperature Operating Life(HTOL)	Ta=125 °C, <u>Vccmax</u> , 1000 hrs	0/22
High Temperature Storage Life(HTSL)	Ta=150 °C, 1000 hrs	0/22
Temperature Humidity bias(THB) (*1)	Ta=85 °C, RH=85 %, <u>Vccmax</u> , 1000 hrs	0/22
Temperature Cycling(TC) (*1)	Ta=-65 °C to 150 °C , 300 cycles	0/22
Latch-Up(LU)	Pulse Current Injection, I=+/-150 mA	0/3
Electrostatic discharge(ESD-HBM)	1.5 <u>kΩ</u> , 100 pF, +/-2000 V, 1 time	0/3
Electrostatic discharge(ESD-CDM)	+/-500V,1time	0/3
Solderability(SD)	245 °C, 5 s, Solder coverage ≥95 %	0/5
Resistance to Soldering Heat(PC)	MSL3(Moisture Sensitivity Level 3)	0/22

* 1) THB,TCはMSL3の前処理を実施しています。

・すべてのサンプルについて、製品仕様を満足することを確認するために電氣的テストを行っています。

注：部材変更前と同じ評価項目で満足している事を確認しています。